

檔 號：
保存年限：

經濟部智慧財產局 審查意見通知函

機關地址：臺北市大安區辛亥路 2
段 185 號 3 樓

聯絡人：阮顯程

聯絡電話：(02)23767329

電子郵件：

傳 真：(02)23779875

受文者：大陸商西安奕斯偉材料科技股份
有限公司（代理人：張耀暉 專
利師、莊志強 專利代理人）

發文日期：中華民國 114 年 2 月 27 日
（114）智專一（作）05286 字第
發文字號：11420219900 號 
速 別：速件 *11420219900*
密等及解密條件或保密期限：
附 件：如文

主旨：第113102144號專利申請案經審查有說明一所述情事，請
於文到次日起3個月內提出申復說明或修正。屆期未申復
說明或修正者，依專利法第46條第2項規定將不予專利，
請查照。

說明：

一、本案經審查認為：

（一）本案「驅動環、承載裝置及雙面研磨裝置」申請日為
113年1月19日，依申請人申請時所提資料進行審查，本
案請求項共12項，其中請求項1、10、12為獨立項，其
餘為附屬項，合先敘明。

（二）依據引證1揭示內容，本案請求項1、10~12不符專利法
第22條第2項之規定。

1、本案請求項1，引證1說明書第[0023]~[0025]段及圖
式第1、2圖已揭示「一種驅動環【相當引證1，元件
符號6】，用於在雙面研磨【相當引證1，雙面磨削】



中支承待研磨的晶圓【相當引證1，元件符號W】，包括基體【相當引證1，元件符號5】，所述基體包括：第一環狀部【相當引證1，元件符號7】，用於通過其內側部沿徑向方向對所述晶圓進行支承；以及第一突出部【相當引證1，元件符號14】，從所述第一環狀部的所述內側部向內突出，以用於伸入所述晶圓的缺口【相當引證1，凹槽】中【見引證1，說明書第[0023]~[0025]段及圖式第1、2圖】」之技術內容；引證1與本請求項之差異為「其中，所述第一環狀部與所述第一突出部是一體成型的」，此僅為引證1「環狀保持器2」結構設計與成型模式之簡單改變，該領域技術人員可視產品需求進行調整與改變進而完成此差異；故所請發明係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成者，不符專利法第22條第2項之規定。

- 2、本案請求項10，其主要技術內容與請求項1相同，僅是請求項1之驅動環應用於承載裝置之中，因此，主要理由如上述理由1；故所請發明係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成者，不符專利法第22條第2項之規定。
- 3、本案請求項11，引證1說明書第[0023]段及圖式第1圖已揭示「其中，還包括支承骨架【相當引證1，元件符號3】，所述支承骨架設置在所述驅動環的徑向外側，以用於在徑向方向上支承所述驅動環【見引證1，說明書第[0023]段及圖式第1圖】」之技術內容；故所請發明係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成者，不符專利法第22條第2

項之規定。

4、本案請求項12，其主要技術內容與請求項10、11相同，僅是請求項10、11之承載裝置應用於雙面研磨裝置之中，因此，主要理由如上述理由10、11；故所請發明係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成者，不符專利法第22條第2項之規定。

(三)本案請求項2~9，於現在時點並未發現不予專利理由，如有發現新的不予專利理由時，會再予以通知。

(四)引證文件

1、TW201417947A。

二、本案如有修正、訂正，應依專利法第43條、第44條第3項、專利法施行細則第36條至第38條之規定辦理，並請依專利修正申請書、專利誤譯訂正申請書之規定撰寫。

三、若需當面示範或說明者，請以「面詢申請書」敘明面詢所依據之版本、面詢事項及說明並繳交規費新台幣1千元，本局認為有必要時，將另行通知面詢地點及時間。

四、檢送本案檢索報告1份。本案檢索報告如附有引證用之非專利文獻，僅供專利申請人個人參考之用，如涉及其他利用該著作之行為(如：列印紙本對公眾散布、將檔案上傳網路等)，仍應取得著作財產權人之同意或授權，以避免侵權。

正本：大陸商西安奕斯偉材料科技股份有限公司（代理人：張耀暉 專利師、莊志強 專利代理人）

副本：

第113102144號專利申請案檢索報告

1. 申請日： 113年1月19日		
2. 優先權日： 2023年11月10日		
3. 本案國際專利分類號(IPC)： B24B 37/08 (2012.01), B24B 37/28 (2012.01), B24B 7/22 (2006.01)		
4. 檢索國際專利分類號(IPC)範圍： B24B		
5. 檢索使用資料庫名稱： 國內外專利資料庫全域檢索系統		
關聯性代碼	引用文獻資料與相關段落處	相關聯請求項
X A	1. TW 201417947 A 2014/05/16 說明書第[0023]~[0025]段及圖式第1、2圖	1、10-12 2-9
A	2. TW 202135155 A 2021/09/16 全文	1-12
A	3. CN 110860998 A 2020/03/06 全文	1-12
A	4. JP 2000-263405 A 2000/09/26 全文	1-12
A	5. CN 102026774 A 2011/04/20 全文	1-12
關聯性代碼說明： X：單獨引用即足以否定發明新穎性或進步性之特別相關的文獻。 Y：結合一或多篇其他文獻後足以否定發明進步性之特別相關的文獻。 A：一般技術水準之參考文獻。 D：說明書已記載之文獻。 E：申請在前、公開／公告在後之專利文獻。 O：公開使用、販賣或展覽陳列之文件。 P：申請日與優先權日間公開之文獻。 L：其他理由引用之文獻。		

完成日： 114年2月26日

檢索歷程

序號	檢索資料庫名稱	檢索式	檢索筆數	引用文獻
1	國內外專利資料庫 全域檢索系統	((奕斯偉材料科技 OR ESWIN MATERIAL TECHNOLOGY)@PA AND (驅動 環 OR 固定環 OR 研磨環 OR 夾持環 OR 保持環 OR 扣環 OR 保持具 OR 保持器 OR 固定器 OR Drive Ring OR Fix* ring OR grind* ring OR clamp* ring OR retain* ring OR buckle ring OR retainer) AND (IC=B24B*)) AND (AD=: 20240119)	11	
2	國內外專利資料庫 全域檢索系統	((驅動環 OR 固定環 OR 研 磨環 OR 夾持環 OR 保持環 OR 扣環 OR 保持具 OR 保 持器 OR 固定器 OR Drive Ring OR Fix* ring OR grind* ring OR clamp* ring OR retain* ring OR buckle ring OR retainer) @AB AND ((晶圓 OR 工件 OR 矽片 OR 硅片 OR 矽盤 OR 基板 OR 基底 OR Wafer OR workpiece OR Silicon Disk OR Substrate) AND (缺口 OR 切口 OR 凹 OR notch OR cut OR concave)) AND (研磨 OR 拋光 OR 擦光 OR 磨光 OR 研光 OR 磨削 OR grind* OR polish* OR buff* OR lapp*) AND (突 OR 凸 OR protrud* OR convex) AND (雙面 OR 兩面 OR 兩側 OR 二面 OR 二側 OR 双面 OR double side* OR two side* OR both side*) AND (IC=B24B*)) AND (AD=: 20240119)	721	1 TW 201417947 A

完成日：114年2月26日

序號	檢索資料庫名稱	檢索式	檢索筆數	引用文獻
3	國內外專利資料庫 全域檢索系統	((驅動環 OR 固定環 OR 研磨環 OR 夾持環 OR 保持環 OR 扣環 OR 保持具 OR 保持器 OR 固定器 OR Drive Ring OR Fix* ring OR grind* ring OR clamp* ring OR retain* ring OR buckle ring OR retainer) @AB AND ((晶圓 OR 工件 OR 矽片 OR 硅片 OR 矽盤 OR 基板 OR 基底 OR Wafer OR workpiece OR Silicon Disk OR Substrate) AND (缺口 OR 切口 OR 凹 OR notch OR cut OR concave)) AND (研磨 OR 拋光 OR 擦光 OR 磨光 OR 研光 OR 磨削 OR grind* OR polish* OR buff* OR lapp*) AND (突 OR 凸 OR protrud* OR convex) AND (雙面 OR 兩面 OR 兩側 OR 二面 OR 二側 OR 双面 OR double side* OR two side* OR both side*) AND (IC=B24B*)) AND (AD=: 20240119)	721	2 TW 202135155 A

完成日：114年2月26日

序號	檢索資料庫名稱	檢索式	檢索筆數	引用文獻
4	國內外專利資料庫 全域檢索系統	((驅動環 OR 固定環 OR 研磨環 OR 夾持環 OR 保持環 OR 扣環 OR 保持具 OR 保持器 OR 固定器 OR Drive Ring OR Fix* ring OR grind* ring OR clamp* ring OR retain* ring OR buckle ring OR retainer) @AB AND ((晶圓 OR 工件 OR 矽片 OR 硅片 OR 矽盤 OR 基板 OR 基底 OR Wafer OR workpiece OR Silicon Disk OR Substrate) AND (缺口 OR 切口 OR 凹 OR notch OR cut OR concave)) AND (研磨 OR 拋光 OR 擦光 OR 磨光 OR 研光 OR 磨削 OR grind* OR polish* OR buff* OR lapp*) AND (突 OR 凸 OR protrud* OR convex) AND (雙面 OR 兩面 OR 兩側 OR 二面 OR 二側 OR 双面 OR double side* OR two side* OR both side*) AND (IC=B24B*)) AND (AD=: 20240119)	721	3 CN 110860998 A

完成日：114年2月26日

序號	檢索資料庫名稱	檢索式	檢索筆數	引用文獻
5	國內外專利資料庫 全域檢索系統	((驅動環 OR 固定環 OR 研磨環 OR 夾持環 OR 保持環 OR 扣環 OR 保持具 OR 保持器 OR 固定器 OR Drive Ring OR Fix* ring OR grind* ring OR clamp* ring OR retain* ring OR buckle ring OR retainer) @AB AND ((晶圓 OR 工件 OR 矽片 OR 硅片 OR 矽盤 OR 基板 OR 基底 OR Wafer OR workpiece OR Silicon Disk OR Substrate) AND (缺口 OR 切口 OR 凹 OR notch OR cut OR concave)) AND (研磨 OR 拋光 OR 擦光 OR 磨光 OR 研光 OR 磨削 OR grind* OR polish* OR buff* OR lapp*) AND (突 OR 凸 OR protrud* OR convex) AND (雙面 OR 兩面 OR 兩側 OR 二面 OR 二側 OR 双面 OR double side* OR two side* OR both side*) AND (IC=B24B*)) AND (AD=: 20240119)	721	4 JP 2000-263405 A

完成日：114年2月26日

序號	檢索資料庫名稱	檢索式	檢索筆數	引用文獻
6	國內外專利資料庫 全域檢索系統	((驅動環 OR 固定環 OR 研磨環 OR 夾持環 OR 保持環 OR 扣環 OR 保持具 OR 保持器 OR 固定器 OR Drive Ring OR Fix* ring OR grind* ring OR clamp* ring OR retain* ring OR buckle ring OR retainer) @AB AND ((晶圓 OR 工件 OR 矽片 OR 硅片 OR 矽盤 OR 基板 OR 基底 OR Wafer OR workpiece OR Silicon Disk OR Substrate) AND (缺口 OR 切口 OR 凹 OR notch OR cut OR concave)) AND (研磨 OR 拋光 OR 擦光 OR 磨光 OR 研光 OR 磨削 OR grind* OR polish* OR buff* OR lapp*) AND (突 OR 凸 OR protrud* OR convex) AND (雙面 OR 兩面 OR 兩側 OR 二面 OR 二側 OR 双面 OR double side* OR two side* OR both side*) AND (IC=B24B*)) AND (AD=: 20240119)	721	5 CN 102026774 A

完成日：114年2月26日

第113102144號發明專利申請案檢索報告引證參考資料

1. TW 201417947 A

<https://tiponet.tipo.gov.tw/gpssl/gpsskmc/gpssbkm?!!FRURLTW201417947>

2. TW 201417947 A

<https://tiponet.tipo.gov.tw/gpssl/gpsskmc/gpssbkm?!!FRURLTW201417947>

3. TW 202135155 A

<https://tiponet.tipo.gov.tw/gpssl/gpsskmc/gpssbkm?!!FRURLTW202135155>

4. CN 110860998 A

<https://tiponet.tipo.gov.tw/gpssl/gpsskmc/gpssbkm?!!FRURLCN110860998>

5. JP 2000-263405 A

<https://tiponet.tipo.gov.tw/gpssl/gpsskmc/gpssbkm?!!FRURLJP2000-263405>

6. CN 102026774 A

<https://tiponet.tipo.gov.tw/gpssl/gpsskmc/gpssbkm?!!FRURLCN102026774>

備註：

這是一個由機器自動產生的檔案，以上所附的引證網址僅供參考。網址若有無法取得、錯誤或失效情形時，申請人可於全球專利檢索系統(GPSS)或其它檢索資料庫另行取得引證文獻。

GPSS網址 <https://tiponet.tipo.gov.tw/gpss/>